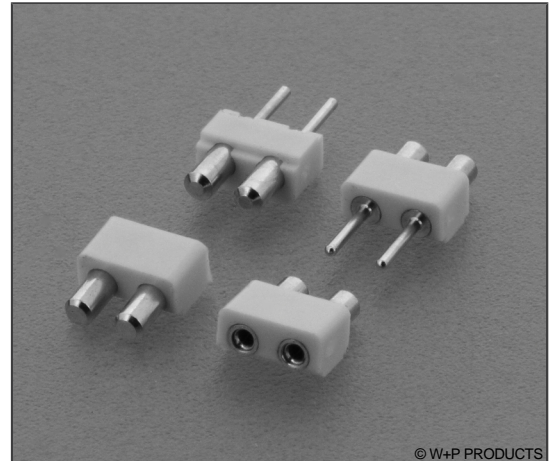
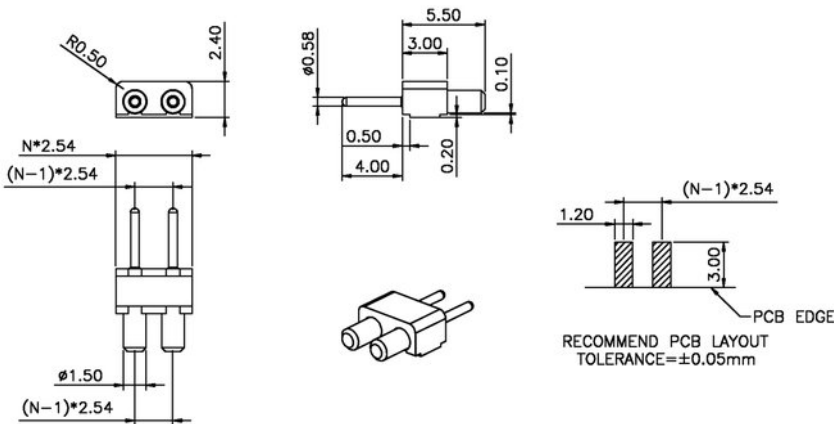


### Technische Daten / Technical Data

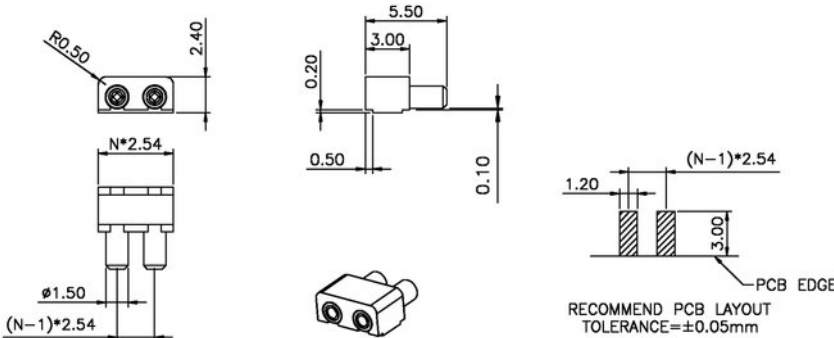
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 HB
<i>Insulator</i>	UL94 V-0 auf Anfrage
	<i>Thermoplastic, rated UL94 HB</i>
	UL94 V-0 on request
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper alloy</i>
Durchgangswiderstand	< 10mΩ
<i>Contact Resistance</i>	< 10mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
<i>Test Voltage</i>	500V <sub>AC</sub>
Nennstrom	1A
<i>Current Rating</i>	1A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
<i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C
Verarbeitung	260°C max. für 3-5s
<i>Processing</i>	260°C max. for 3-5s



© W+P PRODUCTS



<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Version</b>	<b>Colour*</b>	<b>Plating*</b>	<b>Package</b>
<b>5250</b>	<b>02</b> 02-10	<b>1</b> 1 Stifte Male	<b>30</b> 30 Weiß (UL94 HB) White (UL94 HB) 20 Beige (UL94 V-0) Beige (UL94 V-0) 10 Schwarz (UL94 V-0) Black (UL94 V-0)	<b>00</b> 00 Au flash 50 Sn	<b>TR</b> TR Tape & Reel



<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Version</b>	<b>Colour*</b>	<b>Sleeve Plating*</b>	<b>Clip Plating*</b>	<b>Package</b>
<b>5250</b>	<b>02</b> 02-10	<b>2</b> 2 Buchsen Female	<b>30</b> 30 Weiß (UL94 HB) White (UL94 HB) 20 Beige (UL94 V-0) Beige (UL94 V-0) 10 Schwarz (UL94 V-0) Black (UL94 V-0)	<b>00</b> 00 Au flash 50 Sn	<b>00</b> 00 Au flash 50 Sn	<b>TR</b> TR Tape & Reel

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

